



Call for Papers

Deutsche IMAPS Konferenz – 27./28. Oktober 2009, München

Die Deutsche *IMAPS-Konferenz 2009* findet an der Hochschule München in der Nähe des Hauptbahnhofes statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie zu einem der folgenden Themen der Mikroelektronik, des Packaging beziehungsweise der Aufbau- und Verbindungstechnik einen Vortrag von etwa 20 Minuten Dauer halten:

Anwendungsfelder

- Telekommunikation
- Medizintechnik
- Automobilelektronik
- Luft- und Raumfahrt
- Industrieelektronik
- Logistik
- Sensorik

Entwurf

- Designsoftware
- fertigungsgerechtes, testgerechtes Design
- Simulation
- thermische, thermomechanische, Hochfrequenz-, Mikrowellensimulation

Systemaspekte/Problemlösungen

- Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Packaging
- Halbleiter, MEMS, System in Package, Chip Scale Packages, MCM, System on Chip
- Fluidiksysteme
- Optoelektronik
- Mechatronische Systeme
- Hochtemperaturelektronik
- Leistungselektronik
- Hochfrequenzelektronik
- Prüfsysteme

Prozesse und Materialien

- Wafer Level Prozesse
- Keramische und organische Verdrahtungsträger
- Materialien, 3D Formung, HDI-Prozesse, Inkjetdruck, Siebdruck, Fotolithografie, Laserstrukturierung
- Materialien
- (Kleber, Lote und Vergussmassen, Nanomaterialien, funktionelle Schichten)
- Montage- und Verbindungstechnologien
- FlipChip, Drahtbonden, SMT, andere Verfahren
- Prozessüberwachung

Bitte senden Sie Ihren Abstract (ca. 200 Wörter) bis zum **1. Juni 2009** an:

Dr.-Ing. Gisela Dittmar, Ingenieurbüro Elektroniktechnologie Dittmar, Albrecht-Erhardt-Str. 17, D-73433 Aalen,
Tel. +49/7361/931129, Fax +49/7361/943004, gisela.dittmar@imaps.de

Es wird wieder ein BEST PAPER AWARD vergeben !

IMAPS Nordic Conference 2009



IMAPS Nordic gibt die diesjährige Konferenz bekannt, die vom 13./15. September 2009 in Tønsberg/Norwegen stattfindet.

Der Konferenzort liegt an der *Elektronikküste* von Norwegen, an der eine Vielzahl von High-Tech-Unternehmen beheimatet ist. Es ist in etwa 30 Minuten vom *Oslo-Torp-Airport (TRP)* oder in 1 Stunde südlich von Oslo liegend zu erreichen. Sie sind eingeladen, einen Beitrag zur Konferenz einzureichen. Dazu senden Sie bitte ein Abstract zu einem der nachstehenden Themen in elektronischer Form an conference@imapsnordic.org. Abgabetermin ist **30. April 2009**.

- 3D Advanced interconnect, Advanced packaging
- Harsh environment
- Ceramics: thickfilm, copper plated, DBC, LTCC
- Chip thinning & stacking, 3D packaging, embedding
- CSP, flip chips, area array
- Future electronics, trends & strategies
- High frequency packaging
- Integrated passive devices (IPD) & System in Package (SiP)
- Manufacturing management and outsourcing
- MEMS, MOEMS, sensor integration & applications
- High temperature electronics
- Microvia, HDI laminates, flex, embedded passives
- Pb and halogen free electronics, methods and consequences
- Reliability assessment, SPC
- SMT and board assembly
- System cost assessment
- Unique materials, PTF, underfills and ACF, encapsulation
- Wirebonding, COB

Außerdem sind Vorschläge für Tutorials sowie Interessenten für die begleitende Ausstellung willkommen.

Nähere Informationen hierzu können Sie auf <http://imapsnordic.org> und per email bei den Organisatoren unter exhib@imapsnordic.org erfahren.

Micro Tech 2009

Am 2. und 3. März 2009 fand die jährliche Konferenz unserer britischen *IMAPS*-Kollegen statt. Gastgeber war die *Heriot-Watt-Universität* in Edinburgh. Der Fokus der Veranstaltung war Elektronik für biomedizinische Applikationen. So wurden unter anderem neuartige Lösungen für Analysetechnik, Druck-, Fluidik- und Beschleunigungssensoren, Ultraschallsensorarrays und Retina-implantate vorgestellt. Weitere Vorträge beschäftigten sich mit der Hermetisierung von elektronischen Schaltungen und MEMS-Chips, Messverfahren für Hermetizität und Anforderungen an elektronische Systeme bei Implantation in den menschlichen Körper.

Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland

Sie finden die neu gestalteten Webseiten von *IMAPS Deutschland* im Internet unter

<http://www.imaps.de>

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartner von *IMAPS Deutschland e.V.* Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.

Die internationalen Seiten von *IMAPS* erreichen Sie unter

<http://www.imaps.org>

oder für Europa:

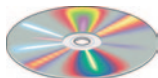
<http://www.imapseurope.org>

Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
Denver/Co.	20./23.4.2009	5 th CICMT	IMAPS & ACeRS
Brno	13./17.5.2009	ISSE 2009	IMAPS CZ+SK, IEEE
Rimini	14./17.6.2009	EMPC 2009	IMAPS Europe
Trento, IT	6./8.7.2009	MEMSWAVE conference	FBK, Amicom, EuMA
Tonsberg, NO	13./15.9.2009	Nordic Conference '09	IMAPS NORDIC
Pszyczyzna, PL	21./24.9.2009	IMAPS Poland conference	IMAPS Polen
München	27./28.10.2009	Herbstkonferenz 2009	IMAPS DE

Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings des IMAPS-Seminars 2009, das am 17. März in Ilmenau unter dem Motto *Ist Zuverlässigkeit noch bezahlbar* stattgefunden hat, können auf CD zum Preis von



€ 55,-

und als Papierausdruck zum Preis von



€ 110,-

erworben werden.

Auch die Proceedings der vorherigen Konferenzen und Seminare sind noch auf CD oder Papiereremplare erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps, c/o Hesse & Knipps GmbH, Vattmannstraße 6, D-33100 Paderborn, Fax: 05251/1560-97, hans-ulrich.knipps@imaps.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß § 4 Nr. 22 UstG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

Impressum

IMAPS Deutschland e.V.

1. Vorsitzender:

Prof. Dr.-Ing. Jens Müller

jens.mueller@imaps.de

Schatzmeister

(bei Fragen zu Mitgliedschaft und Beitrag):

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps

hans-ulrich.knipps@imaps.de

Ausführliche Kontaktinformationen zu den Vorstandsmitgliedern findet man unter *www.imaps.de (Vorstand)*

Flexible und starrflexible Leiterplatten

Von Wolfgang Priem, Klaus Ritz, et al., Erste Auflage 2008, ca. 120 Seiten mit

101 Abbildungen und 7 Tabellen, ISBN 3-87483-228-X, Preis € 68,- inkl. 7% MwSt., zuzüglich Porto

Innerhalb der elektronischen Verbindungstechnik stellen flexible und starrflexible Leiterplatten ein Segment mit sehr hohem Wachstumspotential dar. In diesem Buch wird der gegenwärtige Stand der Produktion dieses Schaltungstyps beschrieben und die steigende Bedeutung dargestellt, die flexible und starrflexible Leiterplatten aufgrund ihrer Eigenschaften für die weitere Entwicklung der Verbindungstechnik in der Elektronik haben.

Das Buch behandelt insbesondere die Unterschiede zur Technologie und in der Applikation der starren Leiterplatte und stellt eine wichtige Informationsquelle für alle diejenigen in der Branche dar, die bisher „nur“ mit starren Leiterplatten befasst waren, sich aber nun mit diesem zukunftsreichen Gebiet der Leiterplatte beschäftigen wollen oder müssen. Es wendet sich vor allem auch an die Entwickler in den OEMs und möchte helfen, dass das Zukunftspotential der flexiblen und starrflexiblen Verbindungstechnik früher erkannt und stärker genutzt wird.

Eugen G. Leuze Verlag KG

Kristalle 4 · D-68348 Bad Soden · Tel. 0 75 81/48 01-0 · Fax 0 75 81/48 01-10

e-mail: brigitte.brosch@leuze-verlag.de · Internet: www.leuze-verlag.de